AMPMODU | AMPMODU Headers

Interne TE-Nummer 5-146268-4

TE-interne Beschreibung: 08 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal
Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 8

Zeilenanzahl: 2

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Abreißen
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	8
Zeilenanzahl	2
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	30 VAC

Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
	100 – 200 μin



Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Quadratisch
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.381 μm[15 μin]
Kontakttyp	Stift
Kontaktnennstrom (max.)	3 A
Klemmenmerkmale	
Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.64 mm[.025 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3.05 mm[.12 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
Montage und Anschlusstechnik	
Art der Leiterplattenmontage	Arretierungslötenden
Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale	
Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast
Abmessungen	
Reihenabstand	2.54 mm[.1 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]
Verwendungsbedingungen	
Gehäusenenntemperatur	Hoch
Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
Betrieb/Anwendung	
Lötververfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal



Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmenge	320
Verpackungs-Typ	Karton

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und CI < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Pin-in-Paste-tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile





TE Teilenr.: 5146140-3 08 MODII HORZ DR CE 100CL



Auch serienmäßig | AMPMODU Headers



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6117)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:414026-2 JACK ASSY, SMB, RT ANG

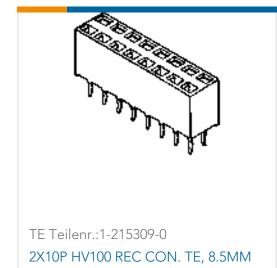


TE Teilenr.:5227161-7 RTANG JACK W/MTG PINS, BNC PCB











3POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY,

SEALED











Dokumente

Produktzeichnungen

08 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-146268-4_E.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-146268-4_E.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-146268-4_E.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu.

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch